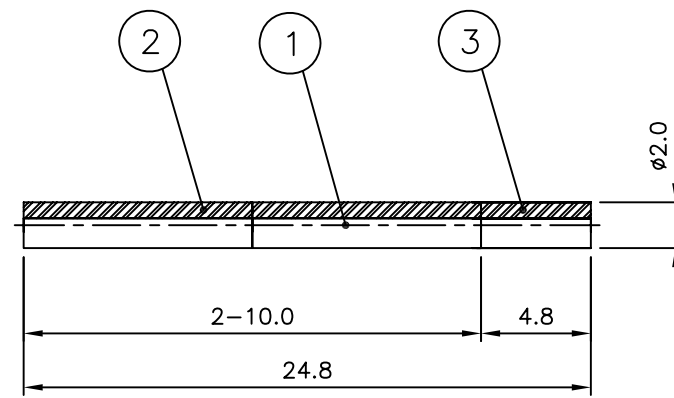


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017.07.26.



★ 조립 후 검사 주의사항

1. PIN과 절연체 조립 후 PIN 양끝단이 절연체 보다 돌출되지 않도록 주의 할 것.
2. PIN+절연체 조립시 헐겁지 않게 관리 필요.
(발주 진행 시 PIN 한도 견본을 절연체 외주 가공업체에 전달하여
조립 후 길이나 절연체가 헐겁지 않게 관리 될 수 있도록 내용 전달 필요.)

3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02934-N/1
2	INSULATOR	2	TEFLON		DIN02923-N/1
1	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03872-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2017. 07. 26.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL		CHECKED BY		KJ COMTECH CO.,LTD. TITLE BUSHING
		DRAWN BY	S.Y.EUN	
FINISH		SCALE 3/1	UNIT mm	 A4 DWG NO. CN03724-7/1 REVISION I R SHEET 1 of 1